第一图书网, tushu007.com

<<微电子封装技术>>

图书基本信息

书名：<<微电子封装技术>>

13位ISBN编号：9787040316674

10位ISBN编号：7040316676

出版时间：2011-8

出版时间：高等教育出版社

作者：张楼英

页数：137

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《高职高专电子制造类专业规划教材：微电子封装技术》将微电子封装技术整个知识体系分成两部分共12章。
第一部分是工艺流程，第二部分是典型封装。
内容包括绪论、晶圆切割、黏晶、芯片互连、模塑、其他工艺流程、双列直插式封装技术、四边扁平封装技术、球栅阵列技术、芯片尺寸封装、多芯片组件封装与三维封装技术以及封装过程中的缺陷分析。
本书可作为高等职业院校、高等专科院校、成人高校、民办高校及本科院校举办的二级职业技术学院以微电子封装技术为重点的电子类专业及相关专业的教学用书，并可作为社会从业人士的业务参考书及培训用书。

<<微电子封装技术>>

书籍目录

第1章 绪论1.1 概述1.2 微电子封装的现状与趋势第一部分 工艺流程第2章 晶圆切割2.1 磨片2.2 贴片2.3 划片2.4 问题与讨论第3章 黏晶3.1 装片的要求3.2 装片过程3.3 装片方法3.4 芯片废弃标准3.5 问题与讨论第4章 芯片互连4.1 概述4.2 引线键合4.3 载带自动焊4.4 问题与讨论第5章 模塑5.1 模塑5.2 问题与讨论第6章 其他工艺流程6.1 去飞边毛刺6.2 电镀6.3 印字6.4 剪切6.5 引脚成形6.6 问题与讨论第二部分典型封装第7章 双列直插式封装技术7.1 CDIP封装技术7.2 PDIP技术第8章 四边扁平封装技术8.1 四边扁平封装的基本概念和特点8.2 四边扁平封装的类型和结构8.3 QFP封装与其他几种封装的比较第9章 球栅阵列技术9.1 球栅阵列的基本概念、特点和封装模型9.2 BGA的制作及安装9.3 BGA检测技术与质量控制9.4 基板9.5 BGA的封装设计9.6 BGA的生产、应用及典型实例第10章 芯片尺寸封装10.1 芯片尺寸封装概述10.2 芯片尺寸封装基板上焊凸点倒装芯片和引线键合芯片的比较10.3 引线架的芯片尺寸封装10.4 柔性板上的芯片尺寸封装10.5 刚性基板芯片尺寸封装10.6 硅片级再分布芯片尺寸封装第11章 多芯片组件封装与三维封装技术11.1 简介11.2 多芯片组件封装11.3 多芯片组件封装的分类11.4 三维（3D）封装技术的垂直互连11.5 三维（3D）封装技术的优点和局限性11.6 三维（3D）封装技术的前景第12章 封装过程中的缺陷分析12.1 金线偏移12.2 芯片开裂12.3 界面开裂12.4 基板裂纹12.5 孑L洞12.6 芯片封装再流焊中的问题12.7 EMC封装成形常见缺陷及其对策附录1 各类协会／学会主要参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com